

证券代码： 688206

证券简称： 概伦电子

上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

2023-11

投资者关 系活动类 别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位 名称	长城基金、东方证券自营、东吴证券、湖南源乘、华安基金、华商基金、华泰柏瑞基金、交银施罗德、南方基金、上海常瑜私募、天弘基金、西南证券自营、兴证全球基金、益恒投资、中泰证券、中邮证券
会议时间	2023年9月13日-9月14日
会议地点	现场交流
上市公司 接待人员 姓名	证券事务代表：郑芳宏 投资者关系经理：杨帆
投资者关 系活动主 要内容介 绍	<p>1. 请问公司在数字芯片相关业务方面的布局 and 策略？</p> <p>答：结合公司的发展历程及技术优势，公司以 DTCO 为核心驱动力，将逐步建立针对工艺开发和制造的制造类 EDA 全流程解决方案，不断完善及提升模拟电路设计类全流程解决方案，全力打造数字电路设计类全流程解决方案。</p> <p>公司在数字电路 EDA 领域有长远布局：一方面，公司收购的韩国 EDA 公司 Entasys 的相当一部分产品为数字电路 EDA 相关的产品，可以为公司在数字领域的发展积蓄基础；另一方面，公司持续加大研发力度，在核心关键点进行自研，本年度公司即将</p>

推出数字仿真关键 EDA 工具，致力于仿真速度和容量的提升，并运用人工智能和机器学习等方式提升效率；同时，利用上市公司平台优势，参与设立了 EDA 专项投资基金，已推动多家 EDA 初创企业的孵化，相关企业的业务方向也涉及数字电路 EDA 领域。

2. 请介绍下评价 EDA 产品的指标及对应排序情况。

答：EDA 产品的指标可简单分为技术指标和工程指标，技术指标指技术领先性，即产品是否能支持先进工艺节点，是否达到国际领先水平；工程指标即用于量产阶段的产品可靠性、稳定性，良率等，以及是否能为客户解决实际问题。综合来看，工程指标直接关系到能否满足客户的实际需求，且与生态壁垒息息相关，在目前阶段的难度是排在前列的。

3. 公司制造类 EDA 的新产品推出节奏？

答：从产品推出节奏上来看，公司更倾向于新的技术和产品得到头部客户验证，以确保市场竞争力和产品价值后，才会考虑大规模市场推广。

近年来，公司在原有建模工具的基础上，陆续优化和推出了一系列新产品。一方面，丰富了 SPICE 建模产品家族，工具涵盖器件模型数据采集分析、基带和射频建模、模型自动化提取和 QA 验证的所有领域；另一方面，填补了公司在制造类 EDA 工具包括在 PDK 和标准单元库环节的空白；本年度，公司还将向市场推出面向可制造性设计（DFM）的 EDA 工具，内置版图大数据算法，基于大规模版图数据库架构，完成一站式热点图形的收集和分析，提高版图设计和修正的稳定性。

同时，公司通过先后投资的多家 EDA 企业，覆盖了其他制造类关键环节 EDA 工具，正在努力加快并联合国内领先的集成电路企业共同打造和验证针对重点芯片应用的、晶圆制造 EDA 全流程。

4. 请问公司产品的迭代过程？

答：从客户日常使用方面来看，越高端越先进的客户对迭代

	<p>的要求和频率也越高，部分高端客户甚至每天都要求对产品进行完善迭代，这种迭代主要指对客户在软件工具使用中遇到的问题进行修复、对部分工具使用功能上进行完善、在工具使用中涉及的新的方法学进行支持等，公司在头部战略客户基本都有驻场工程师，并跟他们在一起进行持续沟通。</p> <p>从产品版本更新迭代方面来看，正常情况下公司主要的产品每年有大约两次大的版本更新，每个月也会根据临时的情况可能有工程版本的更新；但对于部分高端芯片的设计和先进工艺来讲迭代是非常快的，紧急情况下可能每周都会有一次更新。</p> <p>5. 公司的测试系统和 EDA 软件是打包销售的方式吗？如果是打包销售，有什么竞争优势呢？</p> <p>答：公司的软、硬件产品是可以分开单独销售的，并没有要求强制客户在购买 EDA 软件的同时购买测试仪器。</p> <p>半导体器件特性测试系统业务是公司经营业绩增长的重要引擎，高端半导体测试仪器的市场突破是概伦电子以数据驱动 EDA 流程打造创新的 DTCO 解决方案的关键之一：半导体器件特性测试系统采集的数据是器件建模及验证 EDA 工具所需的数据来源，两者具有极强的协同效应。通过半导体器件特性测试系统与 EDA 工具的联动，能够打造以数据为驱动的 EDA 解决方案，紧密结合并形成业务链条，帮助晶圆厂客户有针对性的优化工艺平台的器件设计和制造工艺。</p>
日期	2023 年 9 月 15 日